

Dell EMC PowerEdge C6520

技术规格

注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 技术规格	4
底座尺寸.....	4
机箱重量.....	5
处理器规格.....	5
PSU 规格.....	5
支持的操作系统.....	5
系统电池规格.....	6
扩展卡提升板规格.....	6
内存规格.....	6
驱动器.....	6
存储规格.....	7
端口和连接器规格.....	8
USB 端口规格.....	8
显示屏端口规格.....	8
NIC 端口规格.....	8
iDRAC9 端口规格.....	8
视频规格.....	8
环境规格.....	8
微粒和气体污染规格.....	9
散热限制.....	10

技术规格

本节概述了系统的技术规格和环境规格。

主题：

- 底座尺寸
- 机箱重量
- 处理器规格
- PSU 规格
- 支持的操作系统
- 系统电池规格
- 扩展卡提升板规格
- 内存规格
- 驱动器
- 存储规格
- 端口和连接器规格
- 视频规格
- 环境规格

底座尺寸

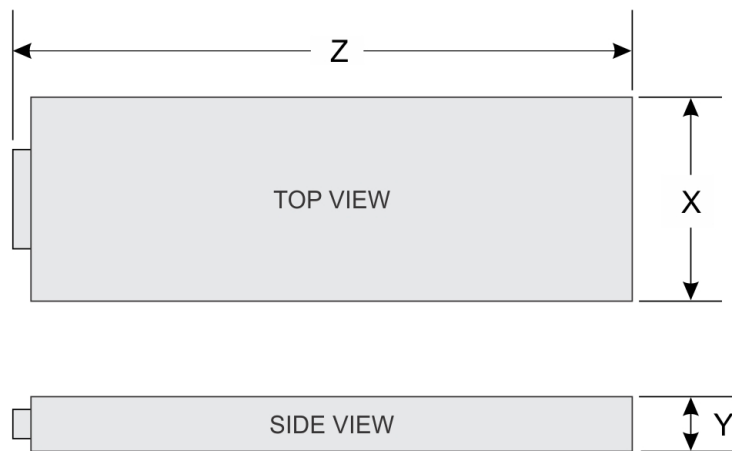


图 1: 底座尺寸

表. 1: PowerEdge C6520 底座尺寸

X	Y	Z
447.04 毫米 (17.6 英寸)	86.36 毫米 (3.4 英寸)	802.64 毫米 (31.6 英寸)

机箱重量

表. 2: 在 PowerEdge C6520 底座的存储模块的机箱重量

系统配置	最大重量 (包括所有底座和驱动器)
12 x 3.5 英寸	45.6 千克 (100.53 磅)
24 x 2.5 英寸	41.4 千克 (91.27 磅)
无背板的系统	35 千克 (77.16 磅)

处理器规格

表. 3: PowerEdge C6520 处理器规格

支持的处理器	支持的处理器数量
第 3 代 英特尔至强可扩展处理器带多达 40 个核心	两个

PSU 规格

PowerEdge C6520 系统支持多达两个交流电源装置 (PSU)。

表. 4: PSU 规格

PSU	分类	散热量 (最大)	频率	电压	交流		当前
					高压线路	低压线路 100-120 V	
2600 W	白金级白金级	9750 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V 自动调节范围	2600 W (220 - 240 V)	1400 W	16 A
2400 W	白金级	9000 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V 自动调节范围	2400 W (200 - 240 V)	1400 W	16 A
2000 W	白金级	7500 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V 自动调节范围	2000 W (200 - 240 V)	1000 W	11.5 A
1600 W	白金级	6000 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V 自动调节范围	1600 W (200 - 240 V)	800 W	10 A

- 注:** 部件编号为 9D4R6 的 2600 W PSU 仅支持 C14-C19 适配器线。
- 注:** 此系统也可连接相间电压不超过 240 V 的 IT 电源系统。
- 注:** 散热量是使用 PSU 的额定功率来计算的。
- 注:** 选择或升级系统配置时, 为了确保最佳电源利用率, 请使用 Dell.com/ESSA 上的戴尔能源智能解决方案顾问验证系统功耗。

支持的操作系统

PowerEdge C6520 系统支持以下操作系统:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux

- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi/vSAN
- CentOS
- Windows 预安装环境 (WinPE) 64 位驱动程序

有关详情，请转至 www.dell.com/ossupport。

系统电池规格

PowerEdge C6520 系统支持 CR 2032 3.0 V 钮扣锂电池系统电池。

扩展卡提升板规格

PowerEdge C6520 系统支持多达四个 PCI express (PCIe) 4.0 扩展卡。

表. 5: 系统板上支持的扩展卡插槽

PCIe 插槽	提升卡	提升板宽度	PCIe 插槽高度	PCIe 插槽长度	PCIe 插槽宽度
插槽 1	转接卡 1a	x16 PCIe	薄型	半长	x8
插槽 1	转接卡 1b, 支持 SNAP I/O 模块	x16 PCIe	薄型	半长	x8 + x8
插槽 2	转接卡 2b	x16 PCIe	薄型	半长	x8

i 注: 有关扩展卡安装原则的信息，请参阅特定于系统的 安装和服务手册，网址: <https://www.dell.com/poweredgemanuals>

内存规格

PowerEdge C6520 系统支持以下内存规格以优化操作。

表. 6: 内存规格

DIMM 类型	DIMM 列	DIMM 容量	单处理器		双处理器	
			最大系统容量	最大系统容量	最大系统容量	最大系统容量
RDIMM	单列	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
	双列	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
		32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
		64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
LRDIMM	四列	64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB
		128 GB	128 GB	1 TB	256 GB	2 TB

表. 7: 内存模块插槽

内存模块插槽	速度
16, 288 针	3200 MT/s、2933 MT/s、2666 MT/s

驱动器

PowerEdge C6520 系统支持:

- 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD) 驱动器
- 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD) /NVMe 驱动器。

表. 8: PowerEdge C6520 底座支持的驱动器选项最大数量

底座中的最大驱动器数	每个底座分配的驱动器的最大数量
12 x 3.5 英寸硬盘系统	每个底座三个 SAS 或 SATA 驱动器和 SATA SSD
24 x 2.5 英寸非 NVMe 驱动器配置	每个底座六个 SAS 或 SATA 驱动器和 SATA SSD
8 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器配置 (每个底座 2 个 NVMe 驱动器/每个机箱 8 个 NVMe 驱动器)	NVMe 背板支持以下配置: <ul style="list-style-type: none"> • 每个底座两个 NVMe 驱动器和四个 SAS 或 SATA 驱动器以及 SATA SSD • 注: NVMe 驱动器限制为 PCIe 3.0 速度。 • 每个底座六个 SAS 或 SATA 驱动器和 SATA SSD
24 x 2.5 英寸 NVMe 驱动器配置	每个底座六个 NVMe 驱动器
M.2 SATA 驱动器 (可选)	M.2 SATA 卡支持的容量高达 960 GB 注: M.2 SATA 卡可以安装到 M.2 提升板或 BOSS 卡上
用于引导的 Micro-SD 卡 (可选) (高达 64 GB)	一个位于 转接卡 1a

注: 有关如何热插拔 NVMe PCIe SSD U.2 设备的更多信息, 请参阅《Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 用户指南》, 位置: <https://www.dell.com/support> **浏览所有产品 > 数据中心基础架构 > 存储适配器和控制器 > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD > 文档 > 手册和文档。**

存储规格

PowerEdge C6520 底座支持:

表. 9: 系统的存储控制器卡

内部控制器	外部控制器
<ul style="list-style-type: none"> • PERC H745 • HBA355i • HBA345 • S150 • H345 • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2 SSD • H350 • H750 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Gbps SAS 外部 HBA

表. 10: 支持的带有 M.2 SATA 驱动器的 RAID 选项

选项	单个 M.2 SATA 驱动器 (不带 RAID)	双 M.2 SATA 驱动器 (带硬件 RAID)
硬件 RAID	否	是
RAID 模式	不适用	RAID 1、RAID 0
支持的驱动器数量	1	2
支持的 CPU	CPU 1	CPU 1

注: RAID 选项仅在支持两个 M.2 SATA 驱动器的 BOSS 卡上受支持。

端口和连接器规格

USB 端口规格

PowerEdge C6520 底座在系统背面支持 USB 3.0。

显示屏端口规格

PowerEdge C6520 底座支持 1 个 Mini-DisplayPort。

NIC 端口规格

PowerEdge C6520 底座支持嵌入在板载 LAN (LOM) 上以及集成在可选的开放计算项目 (OCP) 卡上的一个 10/100/1000 Mbps 网络接口控制器 (NIC) 端口。

表. 11: 底座的 NIC 端口规格

功能部件	规格
LOM 卡	1 GbE
OCP 3.0 卡	1 GbE x 4、10 GbE x 2、25 GbE x 2、25 GbE x 4

iDRAC9 端口规格

PowerEdge C6520 底座支持位于系统背面的 1 个 iDRAC Direct 端口 (Micro-AB USB)。

视频规格

PowerEdge C6520 系统支持集成 Matrox G200 图形控制器和 16 MB 视频帧缓冲区。

表. 12: 系统支持的正面视频分辨率选项

分辨率	刷新率 (Hz)	颜色深度 (位)
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

环境规格


 注: 有关环境认证的其他信息, 请参阅手册和说明文件中的“产品环境数据表”, 网址: www.dell.com/support/home。

表. 13: 工作气候范围类别 A3

温度	规格
可允许连续工作	
海拔高度 <= 900 米 (<= 2,953 英尺) 的温度范围	在设备无直接光照的情况下, 5–40°C (41–104°F)
湿度百分比范围 (所有时间均非冷凝)	8% RH 和 -12°C 最低露点到 85% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点
工作海拔高度降幅	超过 900 米 (2953 英尺) 时, 最高温度按 1°C/175 米 (33.8°F/574 英尺) 降低

表. 14: 所有类别的共享要求

温度	规格
可允许连续工作	
最大温度梯度 (适用于操作时和非操作时)	20°C (一小时) * (36°F [一小时]) 和 5°C (15 分钟) (41°F [15 分钟])、5°C (一小时) * (41°F [一小时]) - 针对磁带 <i>i</i> 注: * — 根据适用于磁带硬件的 ASHRAE 的散热原则, 这些不是温度变化的瞬时速率。
非操作温度限制	-40 至 65°C (-104 至 149°F)
非操作湿度限制	最大露点为 27°C (80.6°F) 时, 相对湿度为 5% 至 95%
最大非工作海拔高度	12,000 米 (39,370 英尺)
最大工作海拔高度	3,048 米 (10,000 英尺)

最大振动规格

表. 15: 最大振动规格

最大振动	规格
使用时	5 Hz 至 350 Hz 时, 0.26 Grms (所有操作方向)。
存储	10 Hz 至 500 Hz 时 1.88 Grms, 可持续 15 分钟 (测试所有六面)。

最大撞击脉冲规格

表. 16: 最大撞击规格

最大撞击	规格
使用时	在正向和负向 x、y、z 轴连续执行了六个 6 G 撞击脉冲, 持续时间长达 11 毫秒 (系统每侧各四个脉冲)。
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持续 2 毫秒。

微粒和气体污染规格

下表定义了限制范围, 帮助避免任何 IT 设备损坏和/或微粒和气体污染故障。如果颗粒或气体污染级别超过指定的限制范围并导致设备损坏或发生故障, 您可能需要改善环境条件。整改环境条件是客户的责任。

表. 17: 微粒污染规格

微粒污染	规格
空气过滤	按照 ISO 14644-1 第 8 类定义的拥有 95% 置信上限的数据中心空气过滤。 <i>i</i> 注: 此情况仅适用于数据中心环境。空气过滤要求不适用于旨在数据中心之外 (诸如办公室或工厂车间等环境) 使用的 IT 设备。 <i>i</i> 注: 进入数据中心的空气必须拥有 MERV11 或 MERV13 过滤。
导电灰尘	空气中不得含有导电灰尘、锌晶须或其他导电颗粒。 <i>i</i> 注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。
腐蚀性灰尘	<ul style="list-style-type: none"> 空气中不得含有腐蚀性灰尘。 空气中的残留灰尘的潮解点必须小于 60% 相对湿度。 <i>i</i> 注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。

表. 18: 气体污染规格

气体污染	规格
铜片腐蚀率	<300 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-2013 定义的 G1 类标准
银片腐蚀率	<200 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-2013 定义的标准

i 注: 腐蚀性污染物最大浓度值在小于等于 50% 相对湿度下测量。

散热限制

i 注:

1. 不可用: 表示不由 Dell EMC 提供的配置。
2. 不受支持: 表示该配置不受热支持。

i 注: 如果环境温度等于或小于以下表格中所列的最大连续操作温度, 包括 DIMM、通信卡、M.2 SATA 和 PERC 卡在内的所有组件都受支持并具有充足的热余裕。

i 注: 某些系统硬件配置需要较低的温度上限。有关操作温度要求的详细信息, 请联系技术支持。

i 注: 某些配置需要一个较低的环境温度。有关更多信息, 请参阅下表。

下表列出了根据系统中配置的 CPU 的环境温度的主要限制。下面提供的所有入口温度均以连续摄氏度为单位。

表. 19: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 空气冷却

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座	无 BP
8380	270	40	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
8368	270	38	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
8368Q	270	38	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
8362	265	32	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
8360Y	250	36	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
8358	250	32	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
8358P	240	32	不支持	不支持	不支持	不支持	20

表. 19: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 空气冷却 (续)

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座	无 BP
6348	235	28	不支持	不支持	不支持	不支持	20
6342	230	24	不支持	不支持	不支持	20	20
8352Y	205	32	20	20	25	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25	25
6338	205	32	20	20	25	25	25
6330	205	28	20	20	25	25	25
6354	205	18	不支持	20	20	20	25
6346	205	16	不支持	20	20	20	25
8352V	195	36	20	20	25	25	25
8352M	185	32	20*	20*	25	25	25
6338N	185	32	20*	20*	25	25	25
5320	185	26	20*	20*	25	25	25
6336Y	185	24	20*	20*	25	25	25
6326	185	16	20*	20*	25	25	25
6330N	165	28	25	25*	25*	25*	25*
6338T	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318Y	165	24	25	25*	25*	25*	25*
5318S	165	24	25	25*	25*	25*	25*
6334	165	8	25	25*	25*	25*	25*
5318N	150	24	25*	30	30	30	30*
5320T	150	20	25*	30	30	30	30*
4316	150	20	25*	30	30	30	30*
5317	150	12	25*	30	30	30	30*
5315Y	140	8	30	30	30*	30*	30*
4314	135	16	30*	30*	30*	30*	30*
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

注:

- 带 * 号的数据表示在此配置中使用具有 HSK 的扩展处理器 1 时，它可以具有温度偏移量 +5°C。
- H745 不支持 TDP > 185 W 的处理器。
- 对于 PCIE > 25 W、128 GB LRDIMM 和 GPU 配置，需要额外的散热限制。

表. 20: 带适用于处理器 1 的 2.5 英寸直接驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座	无 BP
8380	270	40	20	20	20	20	25
8368	270	38	20	20	25	25	25

表. 20: 带适用于处理器 1 的 2.5 英寸直接驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却 (续)

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座	无 BP
8368Q	270	38	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
8362	265	32	20	20	25	25	25
8360Y	250	36	20	20	25	25	25
8358	250	32	20	20	25	25	25
8358P	240	32	20	20	25	25	25
6348	235	28	25	25	25	25	30
6342	230	24	25	25	25	25	30
8351N	225	36	20	20	25	25	25
8352Y	205	32	30	30	35	35	35
6314U	205	32	30	30	35	35	35
8352S	205	32	30	30	35	35	35
6338	205	32	30	30	35	35	35
6330	205	28	30	30	35	35	35
6354	205	18	25	25	30	30	30
6346	205	16	25	25	30	30	30
8352V	195	36	30	30	30	30	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6312U	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

 注: 对于 PCIE > 25 W、128 GB LRDIMM 和 GPU 配置, 需要额外的散热限制。

表. 21: 带 2.5 英寸纯 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续工作温度 - 气冷

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
8380	270	40	不支持	不支持	不支持	不支持
8368	270	38	不支持	不支持	不支持	不支持
8368Q	270	38	不支持	不支持	不支持	不支持
8362	265	32	不支持	不支持	不支持	不支持
8360Y	250	36	不支持	不支持	不支持	不支持
8358	250	32	不支持	不支持	不支持	不支持
8358P	240	32	不支持	不支持	不支持	不支持
6348	235	28	不支持	不支持	不支持	不支持
6342	230	24	不支持	不支持	不支持	20
8352Y	205	32	20	20	25	25
8352S	205	32	20	20	25	25
6338	205	32	20	20	25	25
6330	205	28	20	20	25	25
6354	205	18	不支持	不支持	20	20
6346	205	16	不支持	不支持	20	20
8352V	195	36	20	20	25	25
8352M	185	32	20	20	25	25
6338N	185	32	20	20	25	25
5320	185	26	20	20	25	25
6336Y	185	24	20	20	25	25
6326	185	16	20	20	25	25
6330N	165	28	20*	20*	25*	25*
6338T	165	24	20*	20*	25*	25*
5318Y	165	24	20*	20*	25*	25*
5318S	165	24	20*	20*	25*	25*
6334	165	8	20*	20*	25*	25*
5318N	150	24	25	25	30	30
5320T	150	20	25	25	30	30
4316	150	20	25	25	30	30
5317	150	12	25	25	30	30
5315Y	140	8	25*	25*	30*	30*
4314	135	16	25*	25*	30*	30*
4310	120	12	30	30	35	35
4310T	105	10	30*	30*	35	35
4309Y	105	8	30*	30*	35	35

表. 22: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 空气冷却

处理器	TDP (W)	核心	3 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
8380	270	40	不支持	不支持	不支持
8368	270	38	不支持	不支持	不支持
8368Q	270	38	不支持	不支持	不支持
8362	265	32	不支持	不支持	不支持
8360Y	250	36	不支持	不支持	不支持
8358	250	32	不支持	不支持	不支持
8358P	240	32	不支持	不支持	不支持
6348	235	28	不支持	不支持	不支持
6342	230	24	不支持	不支持	不支持
8351N	225	36	不支持	不支持	不支持
8352Y	205	32	不支持	不支持	不支持
6314U	205	32	不支持	不支持	不支持
8352S	205	32	不支持	不支持	不支持
6338	205	32	不支持	不支持	不支持
6330	205	28	不支持	不支持	不支持
6354	205	18	不支持	不支持	不支持
6346	205	16	不支持	不支持	不支持
8352V	195	36	不支持	不支持	不支持
8352M	185	32	不支持	不支持	不支持
6338N	185	32	不支持	不支持	不支持
5320	185	26	不支持	不支持	不支持
6336Y	185	24	不支持	不支持	不支持
6312U	185	24	不支持	不支持	不支持
6326	185	16	不支持	不支持	不支持
6330N	165	28	不支持	不支持	20
6338T	165	24	不支持	不支持	20
5318Y	165	24	不支持	不支持	20
5318S	165	24	不支持	不支持	20
6334	165	8	不支持	不支持	20
5318N	150	24	不支持	不支持	20
5320T	150	20	不支持	不支持	20
4316	150	20	不支持	不支持	20
5317	150	12	不支持	不支持	20
5315Y	140	8	不支持	20	20*
4314	135	16	不支持	20*	20*
4310	120	12	20	25	25
4310T	105	10	25	30	30

表. 22: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 空气冷却 (续)

处理器	TDP (W)	核心	3 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
4309Y	105	8	25	30	30

表. 23: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却

处理器	TDP (W)	核心	3 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
8380	270	40	不支持	不支持	不支持
8368	270	38	不支持	不支持	不支持
8368Q	270	38	不支持	不支持	不支持
8362	265	32	不支持	不支持	不支持
8360Y	250	36	不支持	不支持	不支持
8358	250	32	不支持	不支持	不支持
8358P	240	32	不支持	不支持	20
6348	235	28	不支持	20	20
6342	230	24	不支持	20	20
8351N	225	36	不支持	不支持	20
8352Y	205	32	20	25	25
6314U	205	32	20	25	25
8352S	205	32	20	25	25
6338	205	32	20	25	25
6330	205	28	20	25	25
6354	205	18	不支持	20	25
6346	205	16	不支持	20	25
8352V	195	36	20	25	25
8352M	185	32	25	30	30
6338N	185	32	25	30	30
5320	185	26	25	30	30
6336Y	185	24	25	30	30
6312U	185	24	25	30	30
6326	185	16	25	30	30
6330N	165	28	25	30	30
6338T	165	24	25	30	30
5318Y	165	24	25	30	30
5318S	165	24	25	30	30
6334	165	8	25	30	30
5318N	150	24	30	35	35
5320T	150	20	30	35	35
4316	150	20	30	35	35
5317	150	12	30	35	35
5315Y	140	8	30	35	35

表. 23: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的单处理器的最大连续工作温度 - 空气冷却 (续)

处理器	TDP (W)	核心	3 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
4314	135	16	30	35	35
4310	120	12	30	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

表. 24: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 液冷

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座	无 BP
8380	270	40	35	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35	35

表. 24: 带 2.5 英寸直接/2.5 英寸 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续操作温度 - 液冷 (续)

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座	无 BP
5315Y	140	8	35	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35	35

注: 对于 PCIe > 25 W、128 GB LRDIMM 和 GPU 配置, 需要额外的散热限制。

表. 25: 带 2.5 英寸纯 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续工作温度 - 液冷

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
8380	270	40	35	35	35	35
8368	270	38	35	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35	35
8362	265	32	35	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35	35
8358	250	32	35	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35	35
6348	235	28	35	35	35	35
6342	230	24	35	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35	35
6338	205	32	35	35	35	35
6330	205	28	35	35	35	35
6354	205	18	35	35	35	35
6346	205	16	35	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35	35
5320	185	26	35	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35	35
6326	185	16	35	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35	35
6334	165	8	35	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35	35

表. 25: 带 2.5 英寸纯 NVMe 驱动器配置的双处理器的最大连续工作温度 - 液冷 (续)

处理器	TDP (W)	核心	6 × 驱动器/底座	4 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
5320T	150	20	35	35	35	35
4316	150	20	35	35	35	35
5317	150	12	35	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35	35
4314	135	16	35	35	35	35
4310	120	12	35	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35	35

注: 对于 PCIe > 25 W、128 GB LRDIMM 和 GPU 配置，需要额外的散热限制。

表. 26: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续工作温度 - 液冷

处理器	TDP (W)	核心	3 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
8380	270	40	35	35	35
8368	270	38	35	35	35
8368Q	270	38	35	35	35
8362	265	32	35	35	35
8360Y	250	36	35	35	35
8358	250	32	35	35	35
8358P	240	32	35	35	35
6348	235	28	35	35	35
6342	230	24	35	35	35
8352Y	205	32	35	35	35
8352S	205	32	35	35	35
6338	205	32	35	35	35
6330	205	28	35	35	35
6354	205	18	35	35	35
6346	205	16	35	35	35
8352V	195	36	35	35	35
8352M	185	32	35	35	35
6338N	185	32	35	35	35
5320	185	26	35	35	35
6336Y	185	24	35	35	35
6326	185	16	35	35	35
6330N	165	28	35	35	35
6338T	165	24	35	35	35
5318Y	165	24	35	35	35
5318S	165	24	35	35	35

表. 26: 带 3.5 英寸直接驱动器配置的双处理器的最大连续工作温度 - 液冷 (续)

处理器	TDP (W)	核心	3 × 驱动器/底座	2 × 驱动器/底座	1 × 驱动器/底座
6334	165	8	35	35	35
5318N	150	24	35	35	35
5320T	150	20	35	35	35
4316	150	20	35	35	35
5317	150	12	35	35	35
5315Y	140	8	35	35	35
4314	135	16	35	35	35
4310	120	12	35	35	35
4310T	105	10	35	35	35
4309Y	105	8	35	35	35

i注: 对于 PCIe > 25 W、128 GB LRDIMM 和 GPU 配置, 需要额外的散热限制。

ASHRAE A3 配置限制

表. 27: ASHRAE A3 配置限制

液冷	空气冷却
<ul style="list-style-type: none"> 不支持 NVMe SSD。 不支持 LRDIMM。 不支持大于 25 W 的 PCIe 卡。 GPU 卡不受支持。 不支持 3.5 英寸驱动器配置。 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持 NVMe SSD。 不支持 LRDIMM。 不支持大于 25 W 的 PCIe 卡。 GPU 卡不受支持。 不支持 3.5 英寸驱动器配置。 对于 1P 底座, 支持的最大 CPU TDP 为 150 W。 对于 2P 底座, 支持的最大 CPU TDP 为 105 W。